LAGENAUFBAU HDI (Standard)

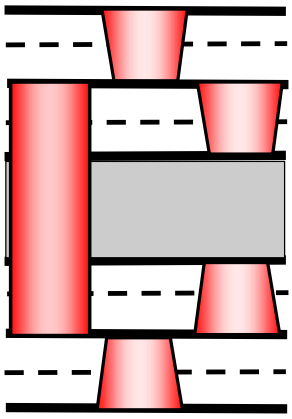
HDI06_2+2(4b)+2_1,60_35

6 - Lagen

Kern: 1,20 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 2(4B) + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	9 µm		30	
					1 x 1080	60	
3	2			35 µm		33	
			1,200 mm			1200	
4	3			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
5	RSK1		Folie	9 µm		30	
					1 x 1080	60	
6	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

		Gesamtdicke Material:				1590	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,60**	+/-	0,14	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,69	+/-	0,17	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,75	+/-	0,19	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	19+